

电子

电子行业周报（2023.05.22-2023.05.28）

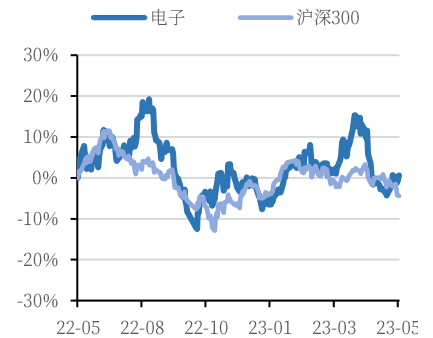
日本半导体设备制裁落地，全面国产化加速推进

投资评级

增持

维持评级

行业走势图



报告摘要

◆ 行情回顾

本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为-0.1%，在申万一级行业涨跌幅中排名第7。电子行业（申万一级）基本持平，大盘下跌，跑赢上证指数2.07pct，跑赢沪深300指数2.28pct。电子行业PE处于近五年42.3%的分位点，电子行业指数处于近五年49.5%的分位点。

◆ 中外半导体进一步脱钩，从去“A”化转向全面国产化。

2023年5月23日，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，并将于7月23日正式施行。本次法案是3月31日，日本产业经济省修改《外汇及外国贸易法》相关法令征求意见稿的正式通过，出口管制范围并未进一步扩大，限制对象包括3项清洗设备、11项成膜设备、1项热处理设备、4项曝光设备、3项蚀刻设备、1项测试设备，共计6大类23项芯片制造设备，且对于较多细节和技术参数限制更为明确。

◆ 日本半导体设备实力强劲，在诸多细分领域占据一席之地。

根据日本半导体制造装置协会数据，2022年日本半导体设备合计出货273.5亿美元，占全球半导体设备市场份额的25.4%。据VLSI Research数据，2021年Top10的半导体设备公司中，日本企业占据四席，其中东京电子TEL位列第3，爱德万Advantest位居第6，迪恩士DNS位列第7，日立国际电气KE位居第9，并且孕育了较多细分领域龙头。TEL作为平台型龙头，2022年在涂胶显影市场份额达89%，干法刻蚀达25%，薄膜沉积市场公司整体份额为34%；清洗设备，尤其是单片清洗领域，DNS独占35%以上，TEL的清洗设备市场份额也高达29%。爱德万测试占全球33%的份额。此外，Nikon与Canon的光刻设备，Ebara的CMP设备，及Disco的晶圆减薄设备均具备全球竞争力。

作者

刘牧野 分析师

SAC执业证书：S0640522040001

邮箱：liumy@avicsec.com

刘一楠 研究助理

SAC执业证书：S0640122080006

邮箱：liuyn@avicsec.com

股市有风险 入市需谨慎

中航证券研究所发布 证券研究报告

请务必阅读正文之后的免责声明部分

联系地址：北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中航产融大厦

中航证券有限公司

公司网址：www.avicsec.com

联系电话：010-59219558 传真：010-59562637

◆ 氧化扩散、刻蚀、光刻等环节对日本强依赖，对标企业有望受益。

根据海关总署数据，2022年中国半导体设备合计进口额为186.8亿美元，其中从日本进口的金额为58.9亿美元，占比31.5%。其中，氧化扩散等热处理设备对日依赖度近60%、其他设备（如清洗、涂胶显影等）从日本进口的金额占比也高达55.2%；此外，31.1%的等离子干法刻蚀设备及约30%的光刻设备也从日本进口。日本限制对华出口，国内对应标的将直接受益，从去“A”到去“J”到全面国产化，也为国内设备公司打开了更大的成长空间。

◆ 建议关注

检测/量测设备：【精测电子】；热处理设备、刻蚀、CVD等：【北方华创】；刻蚀、CVD：【中微公司】；涂胶显影设备：【芯源微】；CVD/ALD：【拓荆科技】；清洗设备：【盛美上海】；CMP、减薄机等：【华海清科】。

◆ 风险提示：

美国制裁蔓延至成熟制程、国内光刻机研发进展不及预期、产能建设进度不及预期。

正文目录

一、 日本半导体设备制裁落地，全面国产化加速推进.....	5
二、 市场行情回顾	8
2.1 本周电子行业位列申万一级行业涨跌幅第 7.....	8
2.2 本周个股表现	8
三、 行业数据跟踪	10
3.1 存储价格趋势.....	10
3.2 面板价格趋势.....	11
3.3 月度进出口数据跟踪.....	12
四、 海外行业新闻动态	13
4.1 SEMI：全球半导体封装材料 2027 年将接近 300 亿美元.....	13
4.2 三星半导体计划减少 10%晶圆投片量	14
4.3 AI 芯片需求远超预期，英伟达财报震撼市场.....	14
五、 国内行业新闻动态	15
5.1 华为完成首批 MetaERP 大规模切换	15
5.2 紫光股份拟定增募资不超 120 亿元收购新华三 49%股权	15
5.3 台积电德国建厂计划仍在谈判中，8 月之前不会做出决定	16

图表目录

图 1 修正草案征求意见的结果公示.....	5
图 2 日本政府本次新增的出口管制对象品类	5
图 3 2021 年全球半导体设备收入 Top10	6
图 4 TEL 的半导体设备收入及中国大陆占比	6
图 5 TEL 主要产品的全球市场份额（CY2022）	6
图 6 2022 年中国大陆 IC 制造设备进口金额及日本进口占比	7
图 7 本周申万一级子行业板块涨跌幅排行	8



图 8 本周申万电子三级子行业板块涨跌幅排行	8
图 9 本周电子行业涨幅前十	9
图 10 本周电子行业跌幅前十.....	9
图 11 DRAM 价格指数.....	10
图 12 NAND 价格指数	10
图 13 国际 Flash 颗粒现货价格（美元）	10
图 14 国际 DRAM 颗粒现货价格（美元）	11
图 15 面板价格趋势（美元/片）	11
图 16 中国大陆集成电路进出口金额及增速	12
图 17 中国大陆集成电路进出口数量及均价	12
图 18 液晶平板显示模组进出口金额及增速	12
图 19 液晶平板显示模组进出口数量及均价	12
图 20 2022 年全球封装材料市场.....	13
表 1 重点关注标的的走势	9

一、日本半导体设备制裁落地，全面国产化加速推进

2023年5月23日，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，并将于7月23日正式施行。本次法案是3月31日，日本产业经济省修改《外汇及外国贸易法》相关法令征求意见稿的正式通过，出口管制范围并未进一步扩大，主要针对先进制程和高端存储芯片制造。

中外半导体进一步脱钩，从去“**A**”化转向全面国产化。美国去年10月7日颁布的新出口管制条例，直接明确用于制造：①16/14nm以下逻辑芯片；②18nm及以下的DRAM芯片；③128层及以上的NAND芯片的半导体设备将受到出口管制，但对于先进与成熟的通用设备存在一定模糊，Lam Research、KLA等美系半导体厂商在最新一期的业绩说明会也表示限制情况好于其最初预期。

本次日本出口管制限制对象包括3项清洗设备、11项成膜设备、1项热处理设备、4项曝光设备、3项蚀刻设备、1项测试设备，共计6大类23项芯片制造设备，且对于较多细节和技术参数限制更为明确。如对光刻机限制的表述为：用于晶圆加工的步进重复法或步进扫描型光刻设备，其中光源波长在193nm及以上，以纳米表示的光源波长(λ)乘以0.25并除以数值孔径数(NA)的数值为小于等于45将受到限制。根据雷利第一公式 $R = k_1 \frac{\lambda}{NA}$ ，则以0.25为工艺介质常数 k_1 代入后，分辨率的要求是 $\leq 45\text{nm}$ ，而ASML能出口的TWINSCAN NXT:1980Di的最小分辨率 $\leq 38\text{nm}$ ，即意味着日本23条中对光刻机的限制超过了ASML，主要是针对Nikon的ArFi光刻机。

图1 修正草案征求意见的结果公示

图2 日本政府本次新增的出口管制对象品类

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果について

カテゴリー	外国為替、貿易
案件番号	595123022
定めようとする命令などの題名	輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 【輸出貿易管理令の運用について】等の一部改正について
根拠法令条項	外国為替及び外国為替法第48条等
行政手続法に基づく手続か	行政手続法に基づく手続
案の公示日	2023年3月31日
受付締切日時	2023年4月29日23時59分
結果の公示日	2023年5月23日
命令等の公布日	2023年5月23日
提出意見数	54
提出意見を踏まえた案の修正の有無	有

【新たに輸出管理の対象となる品目（23品目）】

品目	貨物等省令（第6条第1項）
洗浄（3品目）	第17号ヤからケまで
デポジション（成膜）（11品目）	第17号レからオまで
アニーリング（熱処理）（1品目）	第17号ク
リソグラフィ（露光）（4品目）	第17号ルからワまで、第17号の2
エッチング（化学的除去）（3品目）	第17号カからタまで
検査（1品目）	第17号フ

その他、手続等を定める以下の通達について、所要の改正を行う。

- 輸出貿易管理令の運用について
- 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
- 包括取扱許可要領

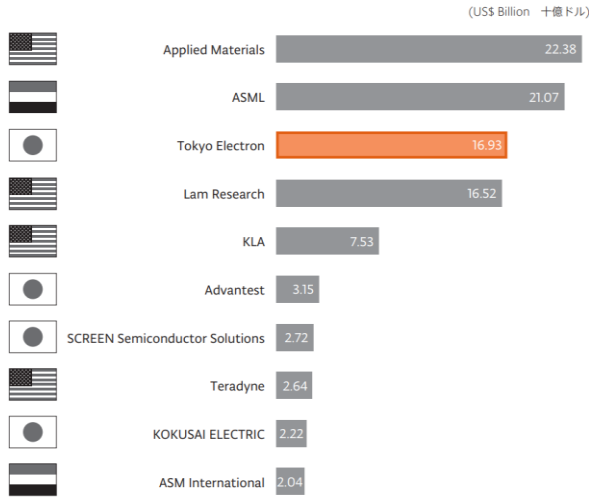
资源来源：日本产业经济省，中航证券研究所

资源来源：日本产业经济省，中航证券研究所

日本半导体设备实力强劲，中国大陆为其重要客户。根据日本半导体制造装置协会数据，2022年日本半导体设备合计出货273.5亿美元，占全球半导体设备市场份额的25.4%。并且孕育了较多细分领域龙头，据VLSI Research数据，2021年Top10的半导体设备公司中，日本企业占据四席，其中东京电子TEL以2021年169.3亿美元的收入规模位列第3，爱德万Advantest位居第6，迪恩士DNS位列第7，日立国际电气KE位居第9。从TEL的收入占比来看，FY2023中国大陆在其设备收入中占

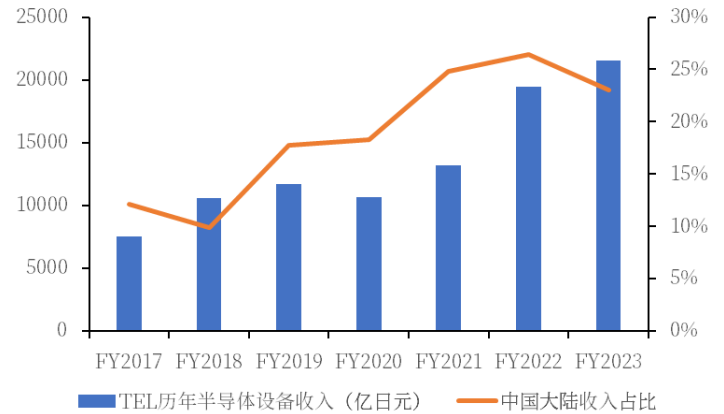
比达 23%，日本政府的 23 条无疑对日本设备企业也会造成一定打击，属于损人不利己的行为，商务部新闻发言人也表示，这是对出口管制措施的滥用，中方对此坚决反对。

图3 2021 年全球半导体设备收入 Top10



资料来源：VLSI Research、TEL、中航证券研究所

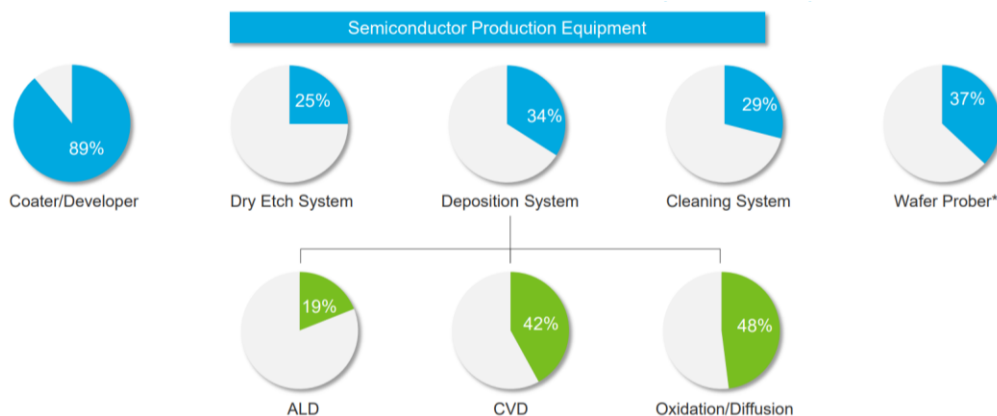
图4 TEL 的半导体设备收入及中国大陆占比



资料来源：TEL，中航证券研究所 (FY23 及 CY22.4-CY23.3)

日本半导体设备在诸多细分领域占据一席之地。TEL 作为平台型龙头，2022 年在涂胶显影市场份额达 89%，干法刻蚀达 25%，薄膜沉积市场公司整体份额为 34%，其中 ALD、CVD、氧化/扩散设备分布占 19%、42%、48%，TEL 的探针台全球市场份额为 37%。清洗设备，尤其是单片清洗领域，DNS、TEL、LAM 和盛美上海合计市占率超过 9 成，其中 DNS 独占 35% 以上，TEL 的清洗设备市场份额也高达 29%。此外，2021 年日本爱德万测试占全球 33% 的份额。其他日本设备公司，如 Nikon 与 Canon 的光刻设备，Ebara 的 CMP 设备，及 Disco 的晶圆减薄设备均具备全球竞争力，国内华海清科已经可以实现 CMP 与减薄设备的部分进口替代。

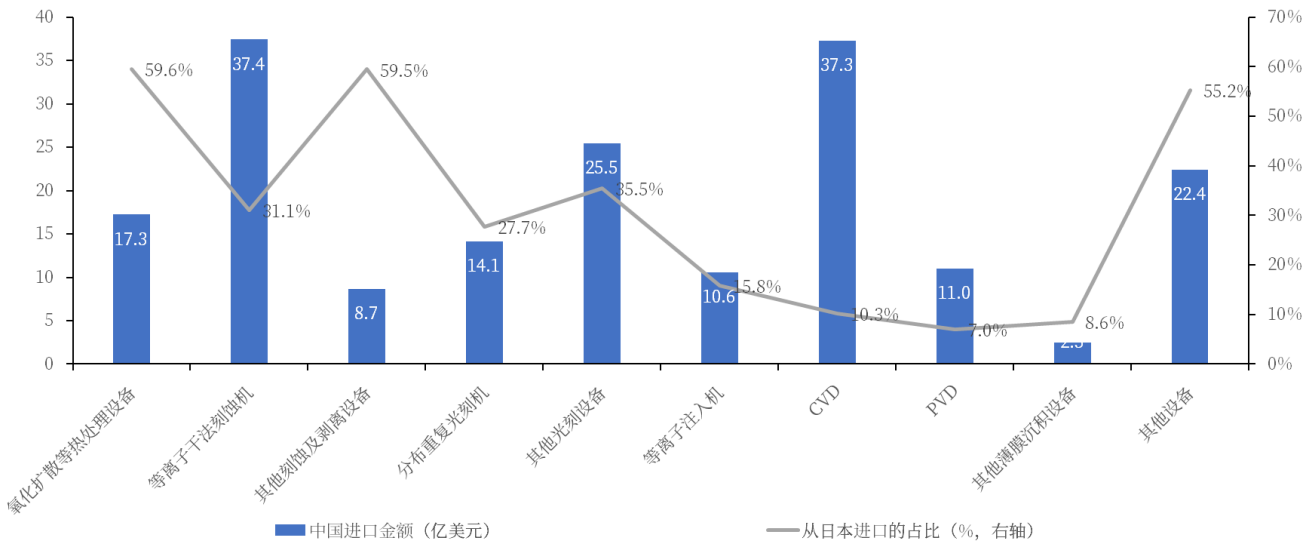
图5 TEL 主要产品的全球市场份额 (CY2022)



资料来源：TEL，中航证券研究所

氧化扩散、刻蚀、光刻等环节对日本强依赖。根据海关总署数据，2022 年中国半导体设备合计进口额为 186.8 亿美元，其中从日本进口的金额为 58.9 亿美元，占比 31.5%。细分品类来看，光刻、刻蚀、薄膜沉积为晶圆制造价值量最大的环节，中国进口的绝对金额较大；从日本进口金额占比来看，氧化扩散等热处理设备对日依赖度近 60%、其他设备（如清洗、涂胶显影等）从日本进口的金额占比也高达 55.2%；此外，31.1%的等离子干法刻蚀设备及约 30%的光刻设备也从日本进口。

图6 2022 年中国大陆 IC 制造设备进口金额及日本进口占比



资料来源：海关总署，中航证券研究所

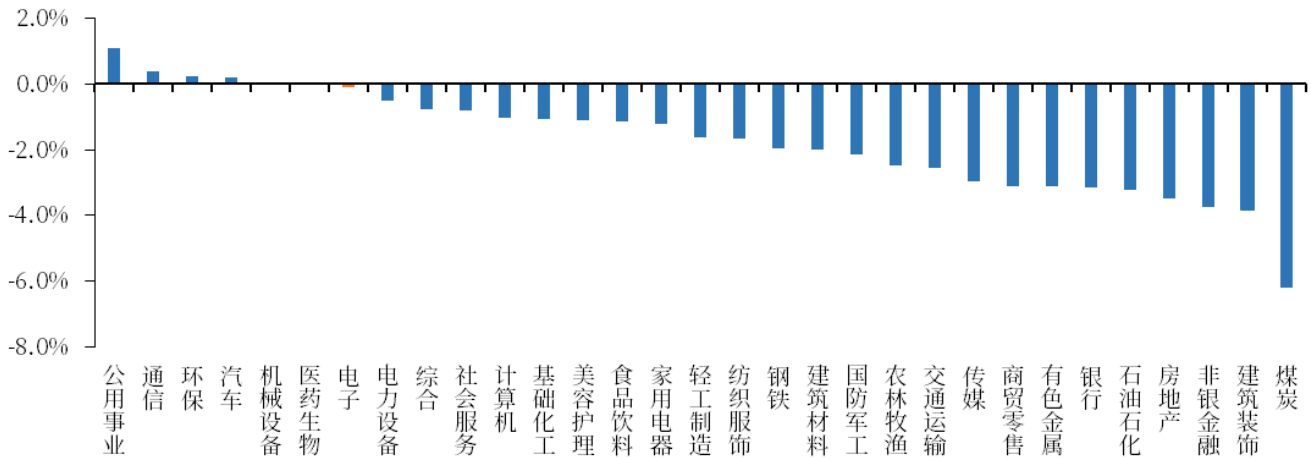
日本限制对华出口，国内对应标的有望受益，且本轮半导体设备板块回调较为充分，配置性价比开始凸显。在美日荷的联合制裁下，国内半导体产业链除自立自强外，不再有其他捷径可走，积极迎难而上、自主可控乃大势所趋。从去“A”到去“J”到全面国产化，也为国内设备公司打开了更大的成长空间。我们从国产替代紧迫性和市场空间综合考虑，建议关注：精测电子-检测/量测；北方华创-热处理设备、刻蚀、CVD 等；中微公司-刻蚀、CVD；芯源微-涂胶显影；拓荆科技-CVD/ALD；盛美上海-清洗设备；华海清科-CMP、减薄机等。

二、市场行情回顾

2.1 本周电子行业位列申万一级行业涨跌幅第 7

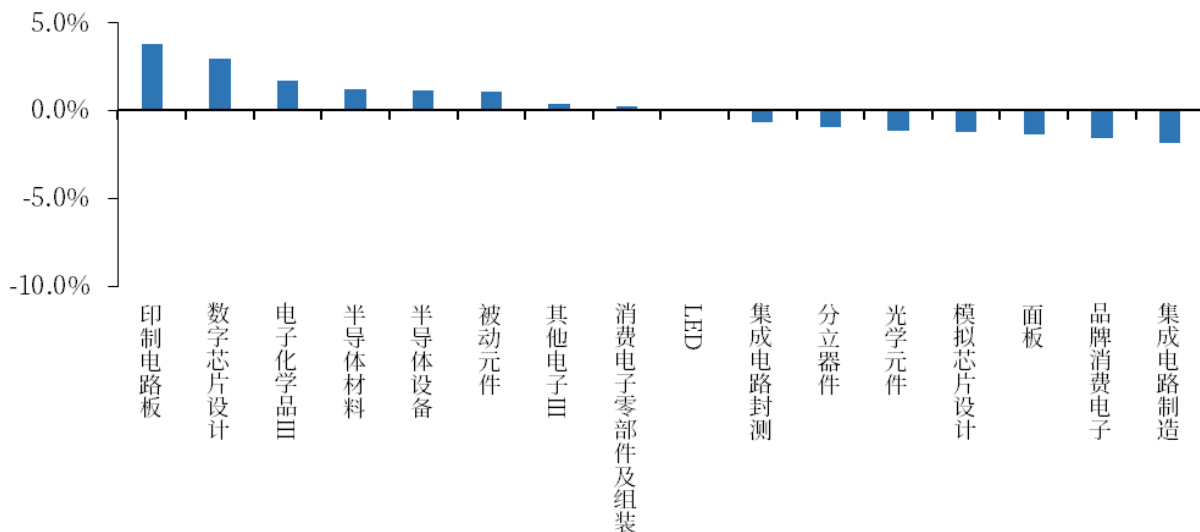
电子（申万）板块指数周涨跌幅为-0.1%，在申万一级行业涨跌幅中排名第 7。

图7 本周申万一级子行业板块涨跌幅排行



资源来源：ifind，中航证券研究所

图8 本周申万电子三级子行业板块涨跌幅排行

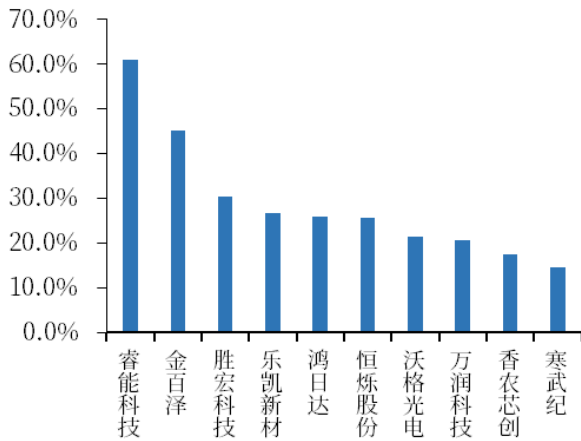


资源来源：ifind，中航证券研究所

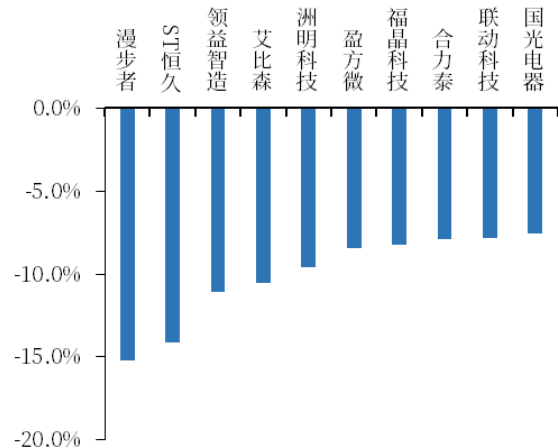
2.2 本周个股表现

本周电子行业涨幅前五：睿能科技 60.97%、金百泽 45.23%、胜宏科技 30.51%、乐凯新材 26.61%、鸿日达 25.81%；

本周电子行业跌幅前五：漫步者-15.19%、ST 恒久-14.16%、领益智造-11.08%、艾比森-10.57%、洲明科技-9.57%。

图9 本周电子行业涨幅前十


资源来源：ifind，中航证券研究所

图10 本周电子行业跌幅前十


资源来源：ifind，中航证券研究所

本周电子行业基本持平，细分赛道中，PCB、数字芯片设计涨幅居前，消费电子、IC制造小幅回调。我们重点关注的公司中，龙芯中科、华海清科涨幅居前。

表1 重点关注标的走势

股票代码	公司	本周涨幅	最新价格：2023-05-26	PE (TTM)
688047.SH	龙芯中科	9.88%	161.71	-1,140.65
002992.SZ	宝明科技	7.75%	58.54	-46.23
688120.SH	华海清科	7.50%	387.01	68.32
002409.SZ	雅克科技	3.85%	72.85	63.20
002484.SZ	江海股份	3.75%	19.93	24.04
002436.SZ	兴森科技	3.00%	14.42	73.37
688601.SH	力芯微	1.96%	75.54	62.73
603986.SH	兆易创新	1.78%	114.00	50.14
002273.SZ	水晶光电	1.28%	11.89	29.80
601208.SH	东材科技	1.18%	12.05	28.80
603306.SH	华懋科技	0.55%	30.90	60.26
603290.SH	斯达半导	0.47%	229.55	44.93
002371.SZ	北方华创	0.11%	301.60	58.33
601231.SH	环旭电子	0.07%	14.04	10.69
600460.SH	士兰微	-0.18%	33.32	47.30
300373.SZ	扬杰科技	-0.23%	43.34	24.30
688268.SH	华特气体	-0.40%	85.50	49.67
688072.SH	拓荆科技	-0.92%	407.23	118.65
603501.SH	韦尔股份	-1.61%	96.10	388.77
688596.SH	正帆科技	-3.45%	38.91	41.37
601127.SH	赛力斯	-3.54%	26.46	-10.95
688141.SH	杰华特	-3.57%	37.51	588.78
300115.SZ	长盈精密	-5.81%	12.96	99.49

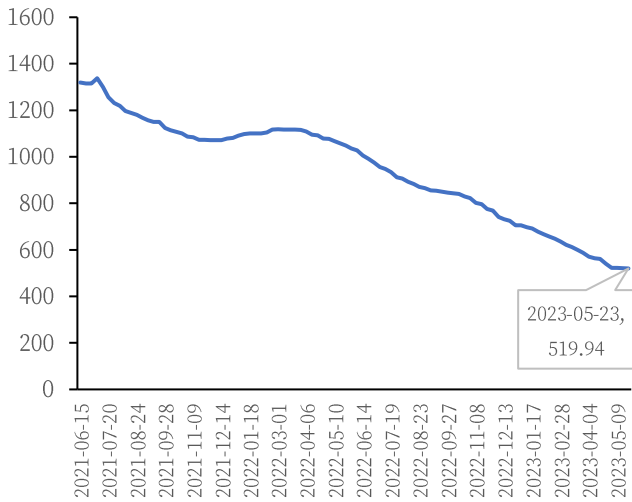
资源来源：ifind、中航证券研究所

三、行业数据跟踪

3.1 存储价格趋势

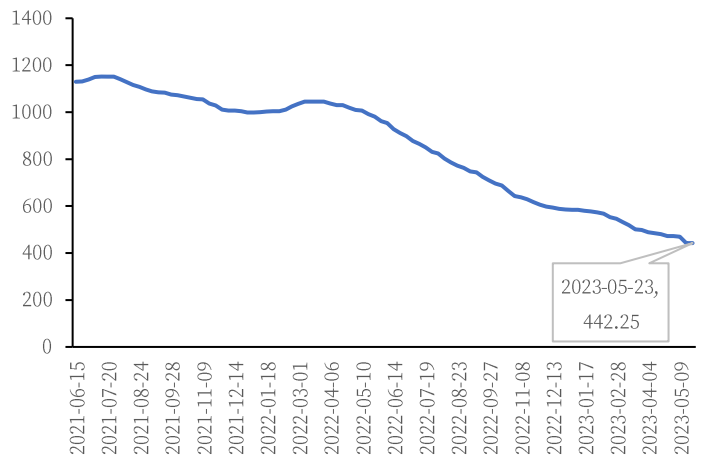
本周 DRAM 与 NAND Flash 现货平均价除少数型号微跌外，主要呈企稳横盘趋势。5月23日，DRAM 价格指数微跌 0.14%至 519.94，NAND 价格指数较前一周维持不变为 442.25。

图11 DRAM 价格指数



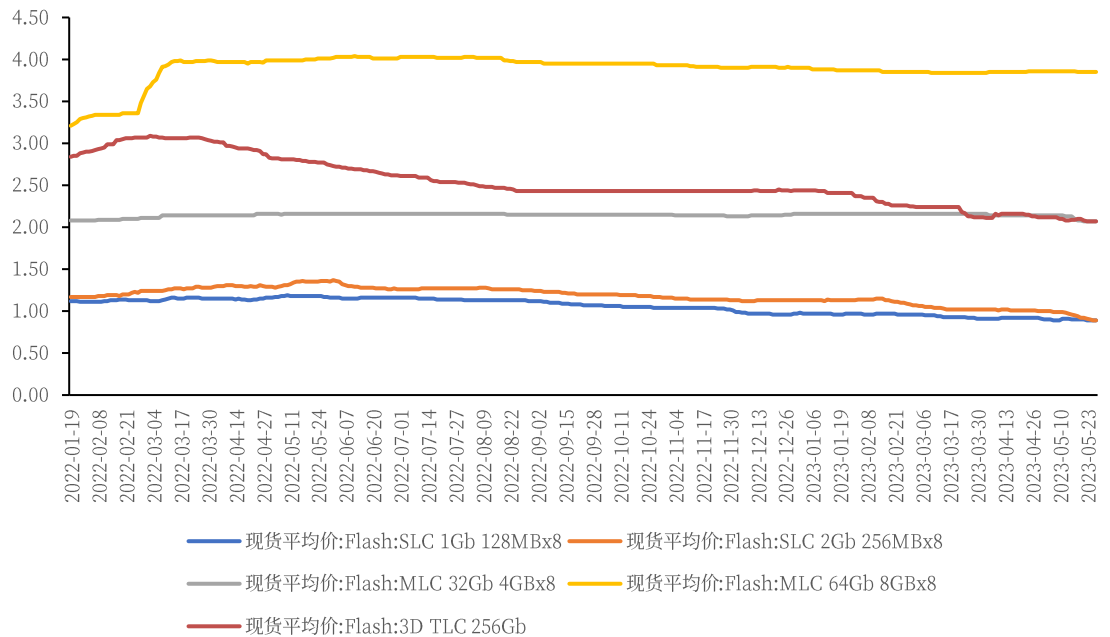
资料来源：iFinD、中国闪存市场、中航证券研究所

图12 NAND 价格指数



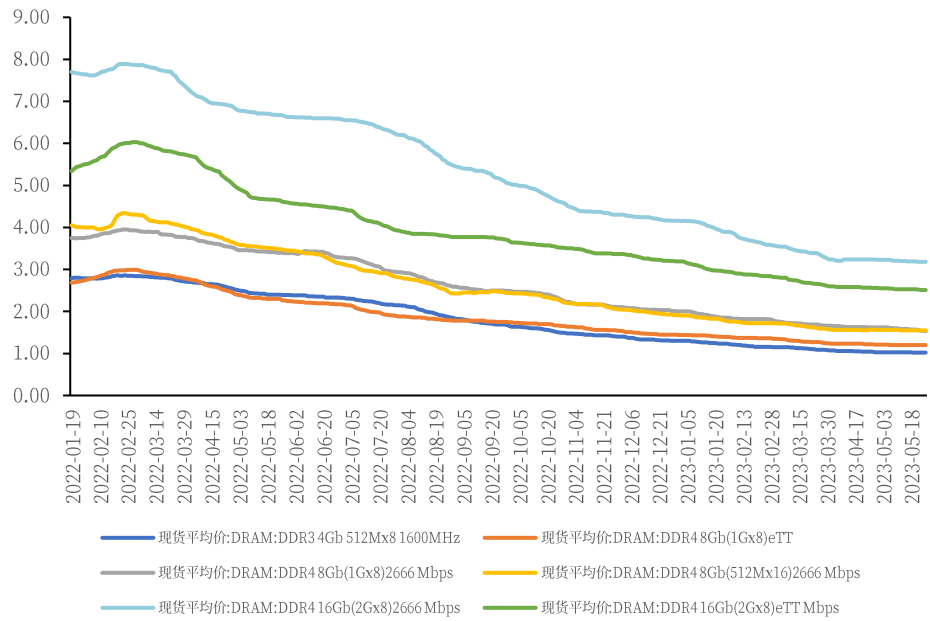
资料来源：iFinD、中国闪存市场、中航证券研究所

图13 国际 Flash 颗粒现货价格（美元）



资料来源：iFinD、DRAMexchange、中航证券研究所

图14 国际 DRAM 颗粒现货价格（美元）

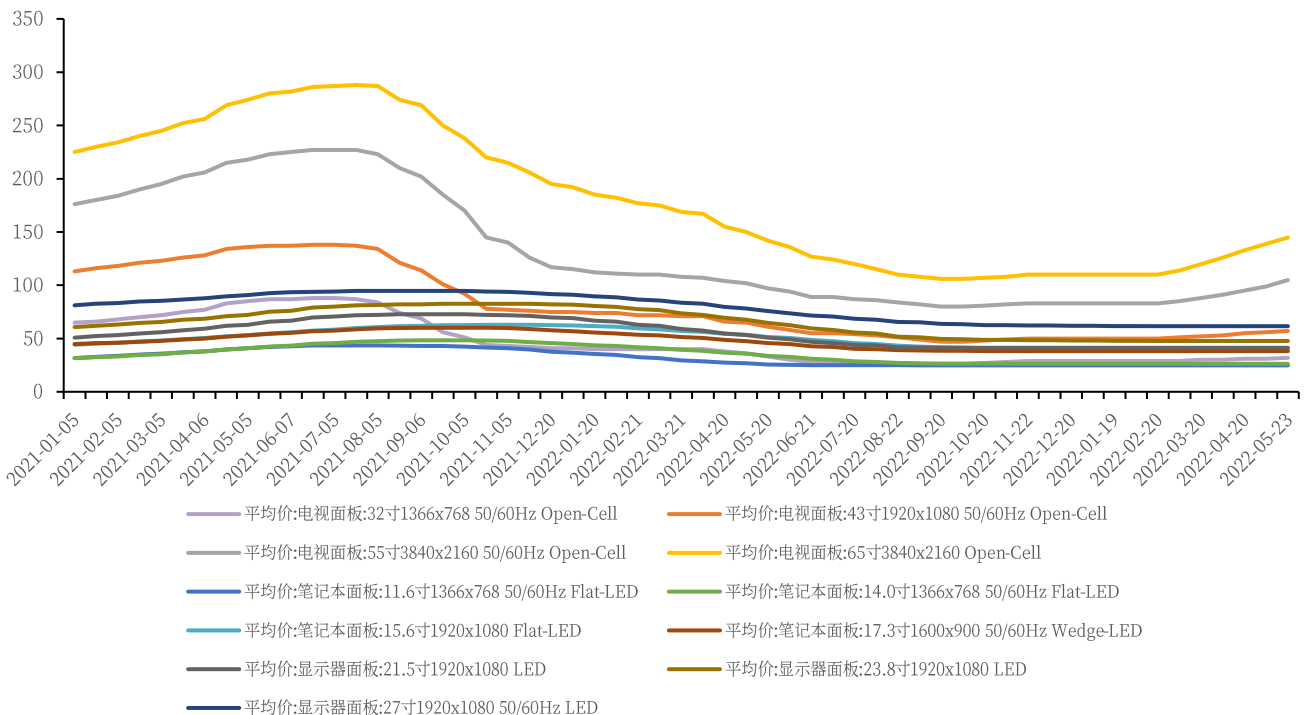


资料来源: iFinD、DRAMexchange、中航证券研究所

3.2 面板价格趋势

根据 WitsView 发布最新调研数据, 5 月下旬, 各尺寸电视面板价格持续上涨, 其他面板均价维持不变。

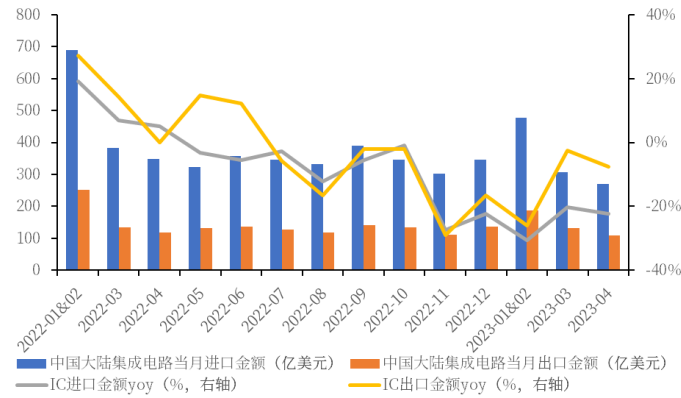
图15 面板价格趋势（美元/片）



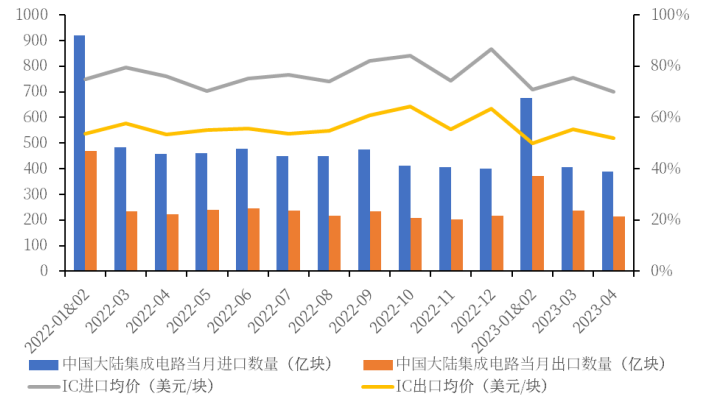
资料来源: iFinD、WitsView、中航证券研究所

3.3 月度进出口数据跟踪

4月，中国大陆集成电路进口金额 271 亿美元，同比-22%；出口金额 110 亿美元，同比-8%，进出口的同环比均继续下滑。4月，IC 进口 387 亿块，对应进口均价 0.70 美元/块，IC 出口 212 亿块，对应出口均价 0.52 美元，进出口均价同环比也有所下滑。

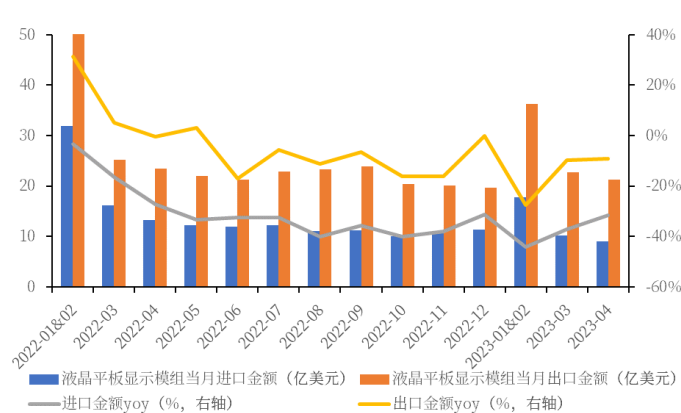
图16 中国大陆集成电路进出口金额及增速


资料来源：海关总署，ifind，中航证券研究所

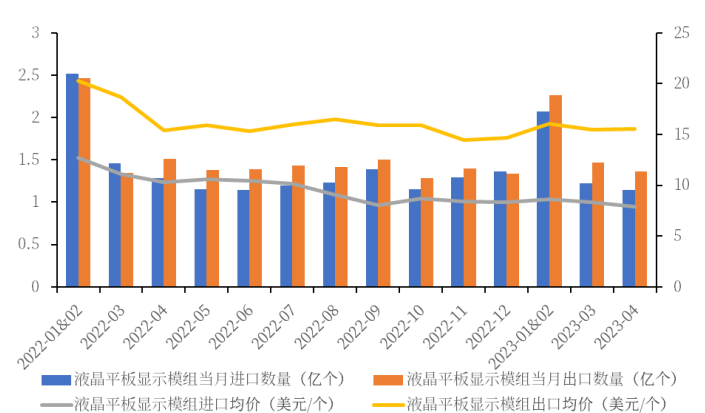
图17 中国大陆集成电路进出口数量及均价


资料来源：海关总署，ifind，中航证券研究所

4月，液晶平板显示模组进口金额 9.0 亿美元，同比-32%；出口金额 21.3 亿美元，同比-9%，进出口金额的同比降幅略有缩窄，环比继续下降；4月，液晶平板显示模组进口 1.1 亿个，对应进口均价 7.9 美元/个，出口 1.4 亿个，对应出口均价 15.6 美元/个，出口均价较 3 月已略有提升。液晶平板显示模组出口数据整体明显好于进口，行业下行期跌幅较小且长期均价较高。

图18 液晶平板显示模组进出口金额及增速


资料来源：海关总署，ifind，中航证券研究所

图19 液晶平板显示模组进出口数量及均价


资料来源：海关总署，ifind，中航证券研究所

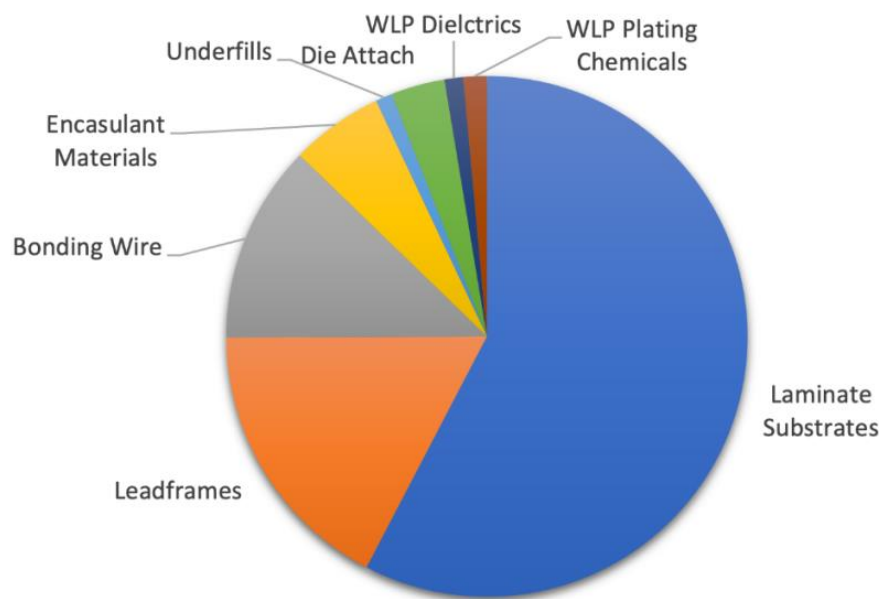
四、海外行业新闻动态

4.1 SEMI：全球半导体封装材料 2027 年将接近 300 亿美元

美国加州时间 2023 年 5 月 23 日, SEMI、TECHET 和 TechSearch International 今天在其最新《全球半导体封装材料市场展望》(Global Semiconductor Packaging Materials Outlook) 报告中宣布: 在电子创新强劲需求的推动下, 预计到 2027 年, 全球半导体封装材料市场将达到 298 亿美元, 复合年增长率为 2.7%, 2022 年销售额为 261 亿美元。

高性能应用、5G、人工智能 (AI) 以及异构集成和系统封装 (SiP) 技术的采用, 正在增加对先进封装解决方案的需求。开发新材料和工艺, 使芯片具有更高的晶体管密度和更高的可靠性, 也有助于市场增长。

图20 2022 年全球封装材料市场



资料来源: SEMI, 中航证券研究所

TechSearch International 总裁兼创始人 Jan Vardaman 表示: “随着新技术和应用推动对更先进、更多样化材料的需求, 半导体封装材料行业正在经历重大变化。介电材料和底部填充的进步推动了对扇入和扇外型晶圆级封装 (FOWLP)、倒装芯片和 2.5D/3D 封装的强劲需求。使用 RDL (再分布层) 的硅中介层和有机中介层等新衬底技术也是封装解决方案的关键增长驱动因素。与此同时, 随着用于构建基板的玻璃芯的开发, 对具有更精细特征的层压基板的研究仍在继续。”

<https://mp.weixin.qq.com/s/bsXCoImSiq1cmSsjurFbsA>

4.2 三星半导体计划减少 10%晶圆投片量

5月26日消息，据韩媒 Aju News 报道，三星计划自 2023 年第三季度开始，对韩国华城园区 S3 工厂减少至少 10%的晶圆投片量。

报道称，三星半导体将在第三季度开始，对华城园区 S3 工厂进行减产作业。S3 工厂是三星半导体于 2018 年建成投产的 12 英寸生产线，目前主要生产 10nm 至 7nm 产品，也是三星半导体 EUV 先进工艺的主力生产厂之一，三星为其部署了多台 ASML 的 NXE 3400 EUV 光刻机。

Aju News 指出，此次减产是三星近几年来首度人为减少半导体工厂晶圆投片量。业内人士指出，在半导体行业低迷期，三星为了逆周期投资以挤压台积电等竞争对手，直至今年年初仍谋求扩大产量，计划到 2023 年下半年提升晶圆产能至少 10%，但半导体行业下滑的速度远超三星预期。

据了解，三星半导体在库产品金额近 32 万亿韩元（当前约 1705.6 亿元人民币），创下有记录以来历史新高。因此，三星不得不继续减产存储器并调涨价格后，又进一步削减系统 LSI 晶圆投片量以期平衡库存。

<https://mp.weixin.qq.com/s/vTT4q9KRf991OpTKyosVhg>

4.3 AI 芯片需求远超预期，英伟达财报震撼市场

路透社 5 月 25 日讯，英伟达公布 2024 年一季度财报。数据显示，英伟达一季度营业收入为 71.92 亿美元（折合人民币约 507.82 亿元），同比下降 13%，但环比增长 19%，高于公司指引区间 63.7 亿到 66.3 亿美元；净利 20.43 亿美元（折合人民币约 144.25 亿元），同比增长 26%，环比增长 44%，高于市场预期 14.899 亿美元；非 GAAP 口径下调整后 EPS 为 1.09 美元，此前分析师预期 0.92 美元。

其中，数据中心收入 43.8 亿美元，超预期 10%；游戏收入 22.4 亿美元，超预期 13%；专业图形收入 3 亿美元，OEM 收入 7700 万美元，自动驾驶收入 3 亿美元。公司指引二季度收入 110 亿美元（+2%），大超市场一致预期（72 亿美元）。

英伟达表示，万亿美元市场的数据中心将从通用用途急剧的转向 AI 用途，并且企业正在竞赛将生成式 AI 应用到所有产品、服务和商业过程，公司的 H100、Grace CPU、Grace Hopper、NvLink、Quantum 400 Infiniband、BlueField 3 DPU 均在生产，公司将大幅增加供给以满足需求。并且预期下半年产能供给比上半年继续提升。

英伟达 CEO 黄仁勋表示，他看到了市场对其数据中心产品的“需求激增”。所以

尽管市场此前预期英伟达下一季度的营收为 71.8 亿美元,但英伟达充满信心地给出了 110 亿美元的指引,比预期高出 50%以上。

财报公布后,收跌约 0.5%的英伟达股价在周三盘后迅速拉升,盘后涨幅超过 28%,一度涨至 390 美元上方的历史最高水平,市值增加约 2000 亿美元至 9600 亿美元,有望成为第七家估值超过 1 万亿美元的美国公司。

<https://mp.weixin.qq.com/s/PW2NdztpHpi5B8CJ3bTeRg>

五、国内行业新闻动态

5.1 华为完成首批 MetaERP 大规模切换

集微网消息,5月22日,华为在心声社区发表题《从决定性胜利走向全面胜利—MetaERP 5月全球覆盖纪实》的文章,其中提到,华为在5月进行了首批 MetaERP 大规模切换,涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美 5 个地区部、6 个账务共享中心、75 个国家,合计 88 家子公司,业务涵盖 ICT、华为云、终端等多个产业。仅用 15 个小时就完成了切换。

华为指出,于5月13日9点开始启动切换,计划在24小时内完成割接,最后仅用15小时就完成全球88家子公司切换成自主可控的MetaERP。本次成功切换,覆盖90%的全球税法和会计准则,完全覆盖全球销售、供应、采购、交付、财经等场景,同时构建了跨领域、跨时区高效协同作战能力。

据华为介绍,MetaERP是华为用自己的操作系统、数据库、编译器和语言做出的软件之一,目前华为已构筑起一套涵盖软件开发全流程、全环节的软件开发生产线,并形成了一站式、全流程、安全可信的作业平台,未来华为将基于该平台开发更多软件,也计划将软件开发工具开放给外界使用,让软件的生产工具走向自主可控,推动国产软件产业链高质量发展。

<https://mp.weixin.qq.com/s/GYjW3VlYJeVxUyOR0yJC2Q>

5.2 紫光股份拟定增募资不超 120 亿元收购新华三 49%股权

5月26日晚间,紫光股份(000938)披露2023年度向特定对象发行A股股票预案显示,公司拟定增募资不超120亿元,用于收购新华三49%股权。

紫光股份表示,本次交易前,公司通过紫光国际持有新华三51%股权。自2016年公司收购新华三控制权以来,新华三的资产质量、收入及利润规模均大幅提升。公

司拟通过收购新华三剩余 49% 股权，将持续优化自身业务，进一步增强数字经济产业布局，发挥协同效应，提升核心竞争力。

据了解，本次收购新华三 49% 股权的价格为 35 亿美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 5 月 25 日（即董事会召开前一日）人民币汇率中间价计算，合计人民币 246.85 亿元。

<https://mp.weixin.qq.com/s/roLw78BXubJsVljwZLIGLw>

5.3 台积电德国建厂计划仍在谈判中，8 月之前不会做出决定

5 月 24 日消息，台积电近日正在荷兰阿姆斯特丹举行欧洲站的年度技术论坛，台积电业务开发资深副总经理张晓强表示，目前台积电对于德国建厂的可能性仍在谈判当中，但在 8 月之前不会做出决定。

张晓强对媒体表示，台积电虽然不想碰触政治方面。但确实认为台积电有必要为客户提供多样化的供应。而且，欧洲是一个考虑到客户群和需求的非常重要的地方。

作为全球最大的晶圆代工商，台积电自 2021 年以来就一直与德国萨克森州针对在德勒斯登设立晶圆厂的可能性进行谈判。此前彭博社的报道显示，台积电正在与合作伙伴讨论，计划在争取到《欧洲芯片法案》的补助支持的情况下，在 2023 年 8 月份的董事会上批准赴德国建立晶圆厂计划。预计将投资最高将接近 100 亿欧元，具体落脚点可能是在德国萨克森州。

对此，德国经济部发言人证实，与台积电的谈判正在进行中，但未提供相关谈判细节。而一旦台积电决定在德国建厂，那么这将是台积电在欧洲的首座晶圆厂。因为欧洲汽车工业的需求，该座晶圆厂预计将会以生产车用 MCU 需求的 28nm 成熟制程开始。

<https://mp.weixin.qq.com/s/D5xFnHfSy0Y4PBZPy8naeg>

公司的投资评级如下:

买入: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数涨幅 10%以上。

持有: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数涨幅-10%~10%之间。

卖出: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。

行业的投资评级如下:

增持: 未来六个月行业增长水平高于同期沪深 300 指数。

中性: 未来六个月行业增长水平与同期沪深 300 指数相若。

减持: 未来六个月行业增长水平低于同期沪深 300 指数。

研究团队介绍汇总:

首席: 赵晓琨 十六年消费电子及通讯行业工作经验, 曾在华为、阿里巴巴、摩托罗拉、富士康等多家国际级头部品牌终端企业, 负责过研发、工程、供应链采购等多岗位工作。曾任职华为终端半导体芯片采购总监, 阿里巴巴人工智能实验室供应链采购总监。长期专注于三大方向: 1、半导体及硬科技; 2、智慧汽车及机器人; 3、大势所趋的新能源。

分析师: 刘牧野 约翰霍普金斯大学机械系硕士, 2022 年 1 月加入中航证券。拥有高端制造、硬科技领域的投研经验, 从事科技、电子行业研究。

销售团队:

李裕淇, 18674857775, liyuqi@avicsec.com, S0640119010012

李友琳, 18665808487, liyoul@avicsec.com, S0640521050001

曾佳辉, 13764019163, zengjh@avicsec.com, S0640119020011

分析师承诺:

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 再次申明, 本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示: 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

免责声明:

本报告由中航证券有限公司(已具备中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格)制作。本报告并非针对意图发送或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示, 否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权, 不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复印本给予任何其他人。未经授权的转载, 本公司不承担任何转载责任。

本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请或向他人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议, 而中航证券不会因接受本报告而视他们为客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠, 但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损失负任何责任, 除非该等损失因明确的法律或法规而引起。投资者不能仅依靠本报告以取代行使独立判断。在不同时期, 中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告仅反映报告撰写日分析师个人的不同设想、见解及分析方法。为免生疑, 本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。

中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易, 向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意, 及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所依据的研究或分析。

联系地址: 北京市朝阳区望京街道望京东园四区 2 号楼中航产融大厦中航证券有限公司

公司网址: www.avicsec.com

联系电话: 010-59219558

传真: 010-59562637